車載エミッション(EMI)規格に 準拠するための電力変換手法



放射ノイズとノイズ耐性を気にする理由







- EMC(電磁環境適合性)に合わせた 設計の重要性
 - 放射ノイズの発生源と種類
 - EMI規格の規制値(CISPR 25)
- ・放射ノイズの低減手法
 - フィルタリング
 - 部品の選択
 - 基板レイアウト
 - 回路技術
- ・事例: CISPR 25 Class 5に合格した

 13.5V入力、3.3V/5A出力のコンバータ

コンバータの事例





一般的な車載コンバータの設計上の課題



90度で配置されたコンデンサ2個



- 12V カーバッテリ用コンバータの広い入力 電圧範囲:約4V~約42V
 高耐圧のFETが必要
- 振動/機械的ストレス
 - 使用できない低EMI電力段構成がある
 - 90度で配置されたコンデンサ2個
 → ESLが増加し、EMI性能劣化
- 温度範囲(標準値-40°C~125°C)
 - ファン冷却がない場合もある(USB充電器など)
- ・ハンダ接合部の目視点検
 - EMI問題が増加するリード付きパッケージが 好まれる場合がある



電源内部からの放射ノイズの発生源





ノイズの周波数スペクトラム(リップル)





車載エミッション要件

- CISPR 25は自動車の共通
 エミッション規格
 - 伝導制限値は150kHz~108MHzに適用
 - 放射制限値は150kHz~
 2.5GHzに適用
- パワー・コンバータは通常、
 <u>AMバンドを回避</u>
 - 通常、450kHz以下または
 2MHz以上のスイッチング
 周波数





車載用とIT/産業用の伝導EMI制限値



- CISPR 32(旧22)はIT装置用のEMI 標準
 - 30MHzまでの周波数スペクトラムに
 わたりギャップのない連続制限線
- 車載用アプリケーションの伝導制限 値(CISPR 25)はさらに難しい
 - 周波数がさらに上(108MHz)まで 伸びる
 - 制限値のレベルが低い
 - 周波数間にギャップのある制限線



差動モードと同相モードのノイズ



- 信号(ノイズ)は一方のワイヤ(+)から 流れ、他方のワイヤ(-)で戻る
- 負荷電流と共に増加
- π フィルタで減衰

- ノイズは両ワイヤに同じ方向に流れ、浮遊 容量とシャーシ・グランド経由で戻る
- 負荷電流にはあまり依存しない
- コモン・モード・チョークでフィルタされる









差動モードEMIフィルタ



- ・降圧コンバータは、C_{IN}に電圧リップルを 発生させるパルス電流を引き込む
- πフィルタにより伝導性の差動モード・
 ノイズを低減
 - L_FとC_Fでローパス・フィルタを形成
 - 安定化のため $C_D \ge R_D \varepsilon$ 追加(EMIフィルタの出力インピーダンス・ピークを低減)







 寄生成分により π フィルタ性能が高い 周波数で劣化



2段構成の π フィルタを使用可能
 2段目にフェライト・ビーズを使用 (L_{F2})



差動モード・ノイズのシミュレーション

- EMIフィルタ性能の洞察が回路シミュレー
 ションから得られる
 - 注意:高周波領域の精度は未知の寄生成分 により制限を受ける
 - シミュレータのオプションを理解すること
- パルス電流源としてモデル化されたパワー
 ・コンバータ
 - 位相インターリーブ、拡散スペクトラムなどを 追加可能
 - FFT機能を使用した回路シミュレータ
- WEBENCH®は入力フィルタ設計ツールを 提供





同相(コモンモード)ノイズの発生源

- ・同相ノイズは主に寄生容量性結合から
 発生
 - CISPR 25で設定されたシャーシ・グランド 上の標準検査高(h)は5cm
 - これより高くても低くても寄生容量は変化

Battery

・スイッチ・ノード(V_{SW})は各スイッチング・ サイクルで同相電流(IPAR)を供給





レイアウトのヒント1:容量性結合を減らす



悪いレイアウト例: 容量性結合が大きい

- - スイッチ・ノードの面積(A)を減らす
 - スイッチ・ノードと敏感な回路間の
 距離(d)を増やす



- スイッチ・ノード(SW、BOOT、スナバ部品など)
 をEMIフィルタ部品や入力接続の近く、または PCB最下層に配置しない
- インダクタの巻始め側の端子をスイッチ・ノード
 に接続
- スイッチ・ノード(ローサイドFETのドレイン)
 に接続されたヒート・シンクに注意



レイアウトのヒント2:アンテナを作らない

- 高di/dt電流が流れるループ面積を最小 にする
 - 降圧:入力コンデンサが重要
 - 昇圧:出力コンデンサが重要



- 渦電流が反対方向の磁場を発生する場所に 切れ目のないグランド・プレーンを作る
- 閉磁経路のある(シールドされた)インダクタ/ トランスを使用して、漏れ磁束結合を減らす

- コンバータによっては、磁場を相殺する ため、入力ピンが対称的に配置される (インダクタンスを低減)
- ICのできるだけ近くに小型の低ESLコン
 デンサを配置する









Texas Instruments

スナバ回路の使用

スナバなしのSWノード



スナバ あり のSWノード										
		/								
		C.	_{sn} =	47	'0p	F、	R_{sn}	=	7.5	Ω

10ns/div

2V/div



- スナバ回路でスイッチ・ノード波形を 整形し、リンギングを低減
 - 抵抗とコンデンサだけでよい
 - 電力損失が増加

$$P = C_{sn} V^2 f_{SW}$$

 スイッチング・ループの寄生インダク タンスLp/容量Cpに基づいて抵抗の 選択を開始

$$R_{sn} = \sqrt{L_p / C_p}$$

スイッチング周波数ディザリング(スペクトラム拡散)

- スイッチング周波数の変調により、放射ノイズ を広い周波数範囲に拡散できる
 - 基本周波数および高調波の放射レベルを低減
- 一般的なディザリング手法:
 - 三角波
 - 疑似ランダム
- 出力電圧リップルが追加発生することがある
- ディザ周波数が可聴範囲内の場合、可聴ノイ ズ発生の可能性







追加のノイズ低減手法

- ・シールド
 - レイアウトでは接地された金属シールドを 考慮すること
 - シールドされていない基板裏面からのノイズ を避ける必要
- 電源ラインのクランプオン・フェライト
 - 同相ノイズ削減に効果
 - 配線ケーブルに取り付け
 - シールドより安価なことが多く、シールドよりよく使われる
 - スリップオン・フェライトでも可

部分シールド





クランプオン・フェライト





CISPR 25 EMIのテスト構成

伝導EMIの構成



放射EMIの構成

放射EMIのテスト前に伝導EMIのテストを実施





疑似回路(2回路)

- 1回路は50Ω 終端
- 1回路はレシー バ接続

バック・ウォール (接地)に接続さ れた銅製トップ・ テーブル



低ノイズのラボ電 源またはカー・バ ッテリ、AN(疑似 回線)入力に接 続

被試験機器、ANか ら20~40cm離す



放射EMIのテスト構成

垂直モノポール

バイコニカル





ログペリ



- ・半無響室(電波暗室)内で試験
 - 壁/天井には吸収材
 - 床には吸収材なし
- 通常、周波数範囲全体の測定用に3本また は4本のアンテナを使用
 - 垂直モノポール:150kHz~30MHz
 - バイコニカル:30MHz~300MHz
 - ログペリ:200MHz~1GHz
 - ホーンまたはログペリ:1GHz~2.5GHz
- 30MHz~2.5GHz測定用に水平/垂直偏波



(非シールド・ルーム) 入力電源ノイズ(負荷あり) 60 25 — 平均制限値(Class 5) — クリーンな電源 20 40 -----ノイズのある電源 Level (dBμV) Level (dBμV) 平均制限值(Class 5) 15 シールド・ルーム 20 非シールド・ルーム 10 0 ц, 5 -20 0 0.1 1 10 30 40 50 70 80 90 100 110 60 Frequency (MHz) Frequency (MHz)

- 低ノイズ電源のあるシールド・ルームが必要(特に30MHz超で)
- バッテリはノイズが最小の電源であるが、充電が必要

構成のノイズ・フロアが低いことを確認

FM放送電波の混信

EMIテスト用レシーバの能力

- 旧式のスキャン式レシーバやスイープ式
 スペクトラム・アナライザは遅い
 - 測定をシーケンシャルにステッピング
 - 総時間 = 測定点の数 × 休止時間
- 新型のEMI試験レシーバでは時間領域 スキャン(TDS: Time Domain scanning) が利用可能
 - 信号を時間領域でサンプル
 - FFTを利用して周波数領域の波形を計算

150kHz~30MHz スキャン・タイプ	ステッピン グされたス キャン時間	時間領域のスキ ャン時間
ピーク	15分以上	150ms未満





事例:LM25141を使用した3.3V/5A電源



本アプリケーションで伝導エミッションに対するEMI低減手法の効果を調査







Class 5に不合格、>20dB超過(平均)

EMI要件合格には、EMI低減手法の利用が必要



周波数ディザリング(スペクトラム拡散)有効化



エミッションは5~10dB減少するが、合格には不十分 — フィルタの追加が必要 注:この結果ではEMIフィルタは取り付けていない







πフィルタ使用で合格するが、余裕はわずか

注:この測定時ディザリングは有効



スナバ有

スイッチ・ノード測定 ($R_{sn} = 1\Omega, C_{sn} = 1nF$)

5V/div

- FM帯域のEMIの増加(Class 5に合格しなくなる)
- •63mWの損失増加

この場合、スナバ回路は伝導エミッション削減に有効ではない

100ns/div

5V/div

注:この測定には、ディザリングとπフィルタが含まれる

100ns/div

スナバ無



ハイサイドFETのゲート抵抗の増加

- HOLとハイサイド・スイッチ・ゲート間の0Ω抵抗を5.1Ω抵抗に交換
 - ハイサイドFETのターンオフ時間を スロー・ダウン





• 電力損失のわずかな増加(21mW)を 測定

簡単かつ低コストな変更でエミッションが2dB減少

注:この測定には、ディザリングと
πフィルタが含まれる



入力ラインにスリップオン・フェライトの追加(オプション)



FMバンドで顕著な減少、低い周波数では減少は小さい

注:この測定には、ディザリングと
πフィルタが含まれる

コモン・モード・チョークの追加(オプション)



周波数スペクトラム全体で減少し、合格の余裕が増加

注:この測定には、ディザリングとπフィルタが含まれる





	周波数 ディザリ ング	差動モードπ フィルタ	スナバ	ゲート抵抗	クランプオ ン・フェラ イト	コモン・モー ド・チョーク
30MHz以下 での減少	5~10dB	40~45dB	0dB	効果なし	1dB	>10dB
30MHz以上 での減少	5~10dB	19dB	-2dB (悪化)	2dB	7dB	5dB
Class 5	不合格、 45dB超過	合格、 0.5dBの余裕	不合格、 2dB超過	合格、 2.5dBの余裕	合格、 2.5dBの余裕	合格、 5dBの余裕
備考		ディザリング 有	ディザリング、 πフィルタ有	ディザリング、 πフィルタ有	ディザリング、 πフィルタ有	ディザリング、 πフィルタ有

注: 結果は平均エミッション測定の結果に注目





- CISPR 25 EMI要件への合格が車載
 システム設計では重要
 - Class 5制限値は小中電力レベルでは 一般的な目標
- ・適切なフィルタリング、設計、レイアウトで 差動/同相EMIに対応可能
- EMIを対策する6つの手法を13.5V入力、
 3.3V/5A出力のコンバータに対して実験
 により評価

事例ボードのEMスキャン





References

- "Understanding and Optimizing Electromagnetic Compatibility in Switchmode Power Supplies," Bob Mamanno & Bruce Carsten, 2002 TI Power Supply Design Seminar
 - <u>http://www.ti.com/lit/slup202</u>
- "Understanding Noise-Spreading Techniques and their Effects in Switch-Mode Power Applications," John Rice, Dirk Gerhke & Mike Segal, 2008/9 TI Power Supply Design Seminar
 - <u>http://www.ti.com/lit/slup269</u>
- "*Effects of Parasitic Parameters on EMI Filter Performance*," S. Wang, F.C. Lee, D. Chen & W.G. Odendaal, IEEE Transactions on Power Electronics, Vol. 19, Issue 3, May 2004
 - <u>https://ieeexplore.ieee.org/document/1296764</u>
- "Power Tips: Calculate an R-C snubber in seven steps," John Betten, Power Tips Blog, May 5, 2016
 - <u>http://e2e.ti.com/blogs_/b/powerhouse/archive/2016/05/05/calculate-an-r-c-snubber-in-seven-steps</u>
- "Understanding EMI and Mitigating Noise in DC/DC Converters," Tim Hegarty, Robert Loke & David Pace, TI Training Video, May 11, 2017
 - <u>https://training.ti.com/understanding-emi-and-mitigating-noise-dcdc-converters</u>
- "Comparison of Time Domain Scans and Stepped Frequency Scans in EMI Test Receivers," Matthias Keller, Rohde
 & Schwarz White Paper, December 2013
 - <u>https://scdn.rohde-</u>

schwarz.com/ur/pws/dl_downloads/dl_application/application_notes/1ee24/1EE24_1e_ESR_Time_Domain_Scan.pdf

JAJP082

